



装置概要

フレキシ印刷機にて塗布された基板上の配向膜または絶縁膜をIRヒーターを上下に搭載し、焼成・硬化処理冷却バッファーを行う装置。基盤投入時に放熱を防ぐため開閉扉がついています。独立した多段炉のため、各段を自由に温度設定が出来ます。

仕様

温度性能	室温～350°（ガラス表面温度）
温度精度	表面温度±5℃以内
方式	マイカヒーター
ヒーター出力	AC200V/50Hz 3φ 10KVA
熱量	10.78mj
圧縮空気	0.5Mpa 50L/min

主な用途先

■半導体・FPD製造関連

